

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2020年度报告摘要

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

根据我国PCB头部厂商深南电路和鹏鼎控股的招股说明书中披露的扩产募投项目设备采购数据,曝光设备投资金额占项目总投资资金额的比例约为17%。

此外,PCB产业技术要求的不断进步,为PCB直接成像设备带来广阔的市场发展空间。根据上海证券报《5G对电子板板的影响研究(二)》,PCB设备已带来影响5G投资扩产研究报告,随着PCB向多层板、HDI板、IC载板等趋势发展,传统曝光技术出现瓶颈,曝光工艺环节将主要采用直接成像技术,从而进一步推动PCB直接成像设备的需求。

在PCB直接成像设备领域,目前主要由由多个系统组成,设备生产工艺复杂,因此技术门槛高,目前行业主要参与者包括以色列Orbotech、日本的ORC、ADTEC、SCREEN以及国内的司、江嘉源、天津芯源、中山新研、太辰光等公司。

近年来,随着半导体与消费电子的不断提升,中国大陆地区成为全球第一大消费电子生产和消费地区。在我国政府的政策大力支持下,通过投入自主研发和引进行业内优秀技术人才等手段,我国泛半导体产业得到了快速发展,其中PCB及FPC产业规模持续快速增长,为泛半导体设备提供了广阔的市场空间。

目前,中国大陆地区已经成为全球第二大半导体设备市场。然而,在泛半导体设备市场需求旺盛的背景下,我国泛半导体设备的自给率还非常低,绝大部分高端装备依赖进口,国产泛半导体设备具有广阔的市场空间。

泛半导体光刻设备具有较高的技术门槛。近年来,我国通过大力投入自主研发和引进行业内优秀技术人才,国内泛半导体产业在集成电路设计、封装测试等领域取得了快速的发展,但是在包括光刻设备在内的泛半导体核心设备领域自给率还非常低,进口依赖十分严重,自主可控任务繁重。

2 公司所处的行业地位分析及变化情况
光刻设备产业属于高技术密集型,资金密集型,具有较高的技术、资金门槛,市场参与者相对较少,国产设备“家独大”格局。目前行业中欧、美、日等发达国家的企业占据主导地位,其设备技术水平及产业规模均处于行业领先地位。在PCB领域,直接成像设备长期依赖进口,但近年来随着我国本土企业技术水平快速发展迅速,国产设备有望凭借性价比、本土售后服务等优势受到国外设备的“进口替代”。在泛半导体领域,高端直写光刻设备长期依赖进口,甚至受到国际封锁,国产设备的总体技术水平与发达国家还存在明显的差距。

在PCB领域,直接成像技术已经得到了成熟的应用,相对于传统曝光技术而言,直接成像技术目前在最小线宽的性价比指标方面能够满足多层板、柔性板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的制造需求,行业内直接成像设备目前能够实现最高线宽可达5μm的线宽,并且生产效率也得到极大的提升。

近年来,在PCB制造领域,电子元件的高度集成化使得中高端PCB产品的层数大幅增加,导线、连接盘、导线的线宽与间距以及使用的介电厚度尺寸全方位缩小,从而导致导线线宽及布线密度大幅提升,传统曝光设备已经无法满足上述中高端产品的制造需求,其次,传统曝光技术需要厚胶层,且所需的制程制造过程工序繁多,对胶片的图形尺寸要求大,出现漏胶和缺陷几率也就越大;第三,在传统曝光过程中,工作环境的湿度、温度对影片尺寸的稳定性和生产直接产生影响,进而影响曝光图形的相对精度,最后,底片的制造也具有一定的物料和人工成本,且底片的使用寿命有限。

此外,根据台湾电路板行业资料,PCB“智能制造”已成为行业的主要发展方向,“智慧运营”、“智慧生产”、“智慧设备”是实现PCB行业“智能制造”的三要素。其中,智慧设备要求PCB生产设备满足产线稼动率分析、设备预防性维护、参与自动线、设备通讯等整合等方面要求。直接成像设备具有明显的自动化特点,能够与其他设备组成自动生产线,且易于对接客户信息化生产系统,符合当下PCB行业“智能制造”技术发展要求。

在上述背景下,无需使用底片的直写光刻设备得到了快速发展,直接成像设备成为目前PCB制造厂商更新设备与未来规划新建产能所选择的主流技术设备路线,市场渗透率得到不断提升。

在IC制造领域,大规模的IC产业化制造使用成熟的影式光刻技术,目前IC制造最先进的IC光刻设备已经实现了7nm最小线宽制程的生产。直写光刻设备在该领域受制于光刻精度以及产能,目前无法满足大规模IC产品的生产需求,主要应用于IC产品等特定应用场景下的最小线宽、多批次产品的生产制造及新产品的研发制造中。在FPC制造领域,影式光刻技术是目前行业广泛应用的,能够实现对最小线宽1.5μm-3μm。同时,FPC制造设备国产化率较低,成本居高不下,产业现状也为直写光刻技术的应用带来了机遇,目前直写光刻技术在FPC低世代产线中已经得到一定程度的产业化应用。

在IC、FPC制造领域,直写光刻技术成为主流光刻技术,采用激光作为光源的直写光刻技术能够满足FPC制造设备对低世代IC制造的需求,采用带电粒子束作为光源的直写光刻技术能够满足FPC制造设备的需求。此外,在IC先进封装领域,由于掩膜光刻在对准灵活性、大尺寸封装以及自动编码等方面存在一定的局限,泛半导体设备厂商近年来将激光直写光刻技术应用于晶圆级封装等先进封装领域,并成功研制了能够用于该领域产业化生产的激光直写光刻设备。

(2)所在行业技术发展分析
直接成像设备及直写光刻设备的技术发展由下游PCB、泛半导体器件等产品的升级趋势驱动。总体而言,目前直写光刻设备的技术发展趋势主要朝四个方向发展,一是实现更精细的线宽及分辨率,二是提升生产效率,三是提升生产效率,四是实现最小线宽和生产效率的平衡与优化。

①实现更精细的光刻精度
目前,下游电子产品持续往集成化、便携化、多功能和高性能方向发展,这对PCB及泛半导体器件制造中的光刻精度提出了更高的要求。在PCB领域,目前IC载板产品代表了最高的光刻水平,实现的最小线宽达到了5μm,追求更精细的线宽及分辨率成为PCB大厂的主要发展方向,直接成像技术已经开始被PCB大厂用于用来取代传统曝光技术的主流技术,泛半导体领域的IC后道封装,日本SCREEN已经推出最小线宽2μm的采用激光直写光刻技术的晶圆级封装光刻设备;在FPC领域,美国Applied Materials已经进行直写光刻的专利布局。

②提升生产效率方面
由于PCB及泛半导体制造均为大规模制造,生产企业具有较高的成本敏感性,生产效率的提升将有效降低产品的单位生产成本,因而受到高度重视。目前行业内主要是通过使用多工作台或多个曝光镜头等手段,实现单位时间内控制更多的曝光光束,并通过优化软件、改善材料配套等方式来提升生产效率。早期的单工作台光刻设备工艺流程(上下片、对准和曝光)只能在单一工作台上按照流程顺序串行完成,而双工作台技术的使用能够实现上下片、对准和曝光的光刻流程在两个工作台上同时并行推进,从而能够大幅提升光刻设备的生产效率。另外,直写光刻技术从最初的单曝光镜头,逐步增加到数十个以及现在的数十个曝光镜头,大幅缩短曝光时间,大大提高了生产效率。除了上述硬件配置的提升外,直写光刻技术的数据处理能力也在通过优化软件的方式得到快速提升。此外在光刻胶套材料方面,针对PCB直接成像设备的高灵敏度、高精度的感光干膜也得到快速发展,从而进一步提升该类设备的生产效率。在泛半导体领域,随着直写光刻技术的不断成熟,在光刻精度为1μm-5μm之间的泛半导体产业化生产中,知名直写光刻设备生产商逐步推出该领域的产品或者进行技术储备。

③提升产品生产率方面
随着生产效率和最小线宽的提升,直写光刻设备的系统模块也在不断增加,系统的热源越来越多。为了确保设备成像效果的稳定性、稳定性,提高核心器件的使用寿命,设备厂商一方面需要对核心器件进行分析和控制,通过控制分析改善设备内部结构和增加环境控制,另一方面需要通过深度学习模型、过程控制技术、软件智能化等技术手段提升光刻设备的稳定性和智能化水平,从而提高光刻制程的良率。

④最小线宽和生产效率的平衡和优化方面
随着最小线宽和生产效率的不断提升,直接成像设备及直写光刻设备将采用更多或者性能更稳定的核心设备成本不断上升,下游客户对于产品生产成本控制需求,对产品单位生产成本低于原有单位生产成本的诉求,才有力地完成设备升级和更换。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2020年, 2019年, 本年比上年增减(%) , 2018年, 2017年. Rows include 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股权结构
4.1 股本及股权结构
单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户). Rows include 截至报告期末普通股股东总数(户), 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户).

4.2 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

4.3 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with 6 columns: 股东名称(全称), 期末持股数量, 持股比例, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

4.4 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内股份质押情况
单位:股

4.5 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人报告期内股份质押情况
单位:股

公司简称:芯碁微装
4.1 股本及股权结构
4.2 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.3 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.4 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.5 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.6 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.7 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.8 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.9 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.10 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.11 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.12 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.13 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.14 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.15 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.16 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.17 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.18 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.19 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.20 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.21 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.22 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.23 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.24 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.25 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.26 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.27 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.28 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.29 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.30 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.31 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

4.32 截止报告期末的普通股前十大股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020年利润分配方案的公告》。

(四)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据2020年度工作情况编制了年度工作报告,2020年度,公司董事会各位董事恪尽职守、认真履职,为公司科学决策、合理履职提出了专业化建议。

(五)审议通过《关于公司2020年度董事述职报告的议案》
公司独立董事在2020年度工作中,勤勉、尽责、独立,独立履行独立董事的职责,向公司董事会提交了述职报告,并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

(六)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会根据公司根据财政部于2018年12月发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]15号)的规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(七)审议通过《关于变更公司地址及修订〈公司章程〉的议案》
公司拟变更注册地址,变更公司地址:【合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期D3#E11层】,变更后公司地址:【合肥市高新区长宁大道789号1号楼】。本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

(八)审议通过《关于变更会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
公司聘请2020年度审计机构为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。该审计机构在2020年度对公司的审计工作中,客观、公正、严谨、认真地履行了职责。同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

(九)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金和自有资金使用效率,合理利用暂时闲置募集资金和自有资金,在不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度的前提下,变更闲置募集资金和自有资金不影响公司正常业务开展的范围内,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。同意计划使用不超过人民币30,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,事项须经2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》
2020年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划指引,各项工作有序有序推进。

(十一)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十二)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十三)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十四)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十五)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十六)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十七)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十八)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(十九)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十一)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十二)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十三)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十四)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十五)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十六)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十七)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十八)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(二十九)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(三十)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(三十一)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(三十二)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(三十三)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。

(三十四)审议通过《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
同意公司向金融机构申请不超过人民币44,000.00万元的综合授信额度,综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。实际融资金额在授信额度内,并以金融机构与公司实际发生的融资金额为准,实际融资金额将视公司运营资金的实际需求而定。以上综合授信额度的授信期限自股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用且单笔融资不再上报董事会股东大会审议,董事会同意授权董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的法律文件(包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件),并办理相关手续。